

次世代産業用レーザー専門委員会および SIP「高付加価値設計製造を実現する
レーザーコーティング技術研究開発「ユーザー連携」推進会議
開催のご案内

主催

(一社) レーザー学会 次世代産業用レーザー技術専門委員会
SIP 次世代レーザーコーティング PJ イノベーションスタイル
(一社) レーザプラットフォーム協議会
大阪大学接合科学研究所

協賛

(一社) レーザ加工学会
オプトロニクス社 / OPIE (<http://www.opie.jp/index.php>)

(一社) レーザー学会 次世代産業用レーザー技術専門委員会 主査
SIP 次世代レーザーコーティング PJ リーダー
(一社) レーザプラットフォーム協議会 会長
塚本 雅裕

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

下記の通り、研究会を開催いたします。今回は、大阪大学接合科学研究所が主体となって実施しております戦略的イノベーション創造プログラム事業 (SIP) /革新的設計生産技術「高付加価値設計・生産技術を実現するレーザーコーティングの研究開発」の成果報告と併せて、レーザー加工関連領域の「最前線」でご活躍中の先生、企業の方のご講演をお願いしております。レーザー加工関連の最新の技術、状況等を入手できる貴重な機会でもありますので、是非ご参加をご検討下さい。

ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。

記

日時：

セッションⅠ：2017年2月24日(金) 13:00～17:00
セッションⅡ：2017年2月24日(金) 18:00～20:00
セッションⅢ：2017年2月24日(金) 21:00～22:30
セッションⅣ：2017年2月25日(土) 9:00～12:00

場所：

セッションⅠ
ライフサイエンスセンター6F 千里ルームA
セッションⅡ～Ⅳ
みのお山荘風の杜、<http://www.minoo-kazenomori.com/>

参加費：

セッションⅠのみ(無料)
セッションⅠ～Ⅳ(1泊2食付会費、17,000円(予定))

参加申込締切：平成29年1月31日(水) 必着

下記申込書にご記入の上、メールにて大阪大学接合研 SIP 次世代レーザーコーティング PJ 事務局(eps@jwri.osaka-u.ac.jp) にご送付ください。

送付先：eps@jwri.osaka-u.ac.jp

尚、定員に達し次第締め切らせて頂きます。

参加申込書

ご氏名：

組織名：

所属：

役職：

住所：

TEL：

FAX：

e-mail：

(e-mailは、到着・返信の重要な連絡先となりますので、明瞭にお書きください。また、小文字、大文字の区別も明確にお願い致します)

セッションⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ (2月24日(金)・25日(土)両日) 参加 ・ 不参加
(不要な方をお消し下さい)

セッションⅠのみ (2月24日(金)) 参加 ・ 不参加
(不要な方をお消し下さい)